（上接D42版）

功率IC产品主要针对高可靠领域客户，封测成本较2023年大幅增加主要系部分产品在销售时增加了独立的电子元器件封装模具及测试费用合计159万元，其中42万元为功率IC封装模具费用，其余为功率IC产品的封装测试筛选费用。2024年因客户要求，塑封成品的销售量占比增加。为满足高可靠领域产品品质的要求，塑封成品需要经过严格的测试及环境试验，从而增加了封装及测试筛选费用。扣除该特定费用后，功率IC的晶圆材料成本、封测成本波动相对较小，具体情况如下：

项目		2024年度		2023年度	
		成本金额（万元）	占比	成本金额（万元）	占比
功率IC	晶圆等材料成本	196.16	88.39%	314.98	91.75%
	封测成本	25.76	11.61%	28.33	8.25%
	小计	221.92	100.00%	343.31	100.00%

综上所述，公司2024年度封测成本上升具有合理性。

三、年审会计师意见

针对上述问题，经我们对公司2024年财务报表审计所执行的相关程序来看，我们认为：

（1）公司补充说明的近三年公司前五大供应商的相关情况与我们核查了解的情况相符；

（2）封测成本占比增长的原因为：功率器件产品中封装成本上升主要受封装成品销售占比上升、封装成品中封测成本占比提升综合影响所致；功率IC主要受本期高可靠领域产品发生的电子元器件测试费用影响所致，剔除该费用后封测成本波动相对较小，具有合理性。

四、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

1、公司已补充说明近三年公司前五大供应商的相关情况；

2、封测成本占比增长的原因为：功率器件产品中封装成本上升主要受封装成品销售占比上升、封装成品中封测成本占比提升综合影响所致；功率IC主要受本期高可靠领域产品发生的电子元器件测试费用影响所致，剔除该费用后封测成本波动相对较小，具有合理性。

三、关于应收账款。

2024年末，公司应收票据和应收账款账面金额分别为2,608.61万元、7,909.95万元，同比变动92.89%、-16.96%。应收票据中商业承兑汇票账面金额2,364万元，同比增长110.13%，环账计提比例为16.05%，较去年大幅上涨。应收账款中，1-2年账龄的应收账款账面金额1,084.03万元，同比增长997%。同时应收账款余额中收到客户转让的中国电子惠融账单合计715.70万元。请公司：（1）按票据类型分别列示商业承兑汇票基本信息，包括但不限于出票人、承兑人、票面余额、交易背景、交易内容、贴现或背书情况、票面到期日、期后兑付情况等；（2）结合历史违约情况，说明商业承兑汇票环账计提比例上升的原因；（3）说明应收账款期后回款情况，并结合主要应收客户与账龄1-2年应收账款客户的还款能力和信用风险，说明相关款项的收回是否存在风险、环账准备的计提是否充分；（4）补充说明中国电子惠融账单相关信息、产生的原因以及相关款项回收是否存在困难。

回复：

一、按票据类型分别列示商业承兑汇票基本信息，包括但不限于出票人、承兑人、票面余额、交易背景、交易内容、贴现或背书情况、票面到期日、期后兑付情况等。

（一）公司2024年度商业承兑汇票总体情况

单位:万元

票据分类	期初		本期收到		到期托收		期末余额	
	张数	面值合计	张数	面值合计	张数	面值合计	张数	面值合计
商业承兑汇票	34	1,221.63	132	4,480.59	105	2,886.63	61	2,815.59

公司收到的商业承兑汇票均持有到期，无对外背书或贴现的情形。

（二）期末商业承兑汇票情况

公司期末持有的商业承兑汇票的出票人、承兑人、票面余额、交易背景、交易内容、票面到期日、期后兑付情况如下：

票据种类	出票者名称	承兑人名称	汇票金额（元）	出票日	到期日	前手单位的交易背景	与前手单位的交易背景	交易内容	截至2025年4月30日是否已到期	到期收款情况（元）
商业承兑汇票	客户A	客户A	4,612,565.22	2024-12-31	2025-6-25	客户A	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户A	客户A	2,931,241.49	2024-12-29	2025-6-25	客户A	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户O	客户O	2,000,000.00	2024-9-29	2025-3-28	客户O	客户	高可靠领域集成电路产品	是	2,000,000.00
商业承兑汇票	客户O	客户O	1,900,000.00	2024-12-31	2025-6-30	客户O	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户A	客户A	1,761,736.22	2024-12-31	2025-6-25	客户A	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户E	客户E	1,419,866.00	2024-12-30	2025-6-30	客户E	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户B	客户B	1,330,000.00	2024-9-25	2025-3-25	客户B	客户	高可靠领域集成电路产品	是	1,330,000.00
商业承兑汇票	客户B	客户B	1,260,000.00	2024-8-23	2025-2-21	客户B	客户	高可靠领域集成电路产品	是	1,260,000.00
商业承兑汇票	客户B	客户B	1,190,000.00	2024-7-25	2025-1-24	客户B	客户	高可靠领域集成电路产品	是	1,190,000.00
商业承兑汇票	客户A	客户A	1,015,928.76	2024-12-31	2025-6-25	客户A	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户L	客户L	673,268.00	2024-7-4	2025-1-4	客户L	客户	高可靠领域集成电路产品	是	673,268.00
商业承兑汇票	客户M	客户M	666,289.00	2024-10-25	2025-4-25	客户M	客户	高可靠领域集成电路产品	是	666,289.00
商业承兑汇票	客户B	客户B	604,831.70	2024-7-25	2025-1-24	客户B	客户	高可靠领域集成电路产品	是	604,831.70
商业承兑汇票	成都天奥电子股份有限公司	成都天奥电子股份有限公司	500,000.00	2024-10-26	2025-4-23	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	500,000.00
商业承兑汇票	客户N1	客户N1	500,000.00	2024-12-31	2025-6-30	客户N1	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户M	客户M	456,280.00	2024-7-24	2025-1-24	客户M	客户	高可靠领域集成电路产品	是	456,280.00
商业承兑汇票	客户E	客户E	398,810.00	2024-7-19	2025-1-18	客户E	客户	高可靠领域集成电路产品	是	398,810.00
商业承兑汇票	客户G	客户G	363,870.00	2024-8-29	2025-2-28	宜兴市智芯半导体科技有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	363,870.00
商业承兑汇票	客户F	客户F	328,003.00	2024-12-25	2025-6-25	客户F	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户L	客户L	313,750.00	2024-7-29	2025-1-29	客户L	客户	高可靠领域集成电路产品	是	313,750.00
商业承兑汇票	成都西科微波通讯有限公司	成都西科微波通讯有限公司	300,000.00	2024-11-21	2025-5-19	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	中航捷锐(西安)光电技术有限公司	中航捷锐(西安)光电技术有限公司	300,000.00	2024-11-29	2025-5-29	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户P	客户P	286,034.00	2024-11-1	2025-5-1	客户P	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	四川升华电源科技有限公司	四川升华电源科技有限公司	250,750.00	2024-12-26	2025-6-26	四川升华电源科技有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	四川升华电源科技有限公司	四川升华电源科技有限公司	215,932.00	2024-11-26	2025-5-26	四川升华电源科技有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	北京无线电测量研究所	北京无线电测量研究所	200,000.00	2024-8-13	2025-2-13	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	200,000.00
商业承兑汇票	客户B	客户B	200,000.00	2024-10-28	2025-4-28	客户B	客户	高可靠领域集成电路产品	是	200,000.00
商业承兑汇票	客户M	客户M	185,975.00	2024-11-19	2025-5-19	客户M	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户F	客户F	175,250.00	2024-9-12	2025-3-12	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	175,250.00
商业承兑汇票	客户L	客户L	172,021.50	2024-12-26	2025-6-26	客户L	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户F	客户F	168,320.50	2024-12-25	2025-6-25	客户F	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	兰州飞行控制有限责任公司	兰州飞行控制有限责任公司	158,112.00	2024-10-28	2025-4-28	西安伟京电子制造有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	158,112.00
商业承兑汇票	中国船舶集团有限公司第七一七研究所	中国船舶集团有限公司第七一七研究所	119,757.00	2024-12-24	2025-6-24	西安伟京电子制造有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户N1	客户N1	100,000.00	2024-7-2	2025-1-2	客户N1	客户	高可靠领域集成电路产品	是	100,000.00
商业承兑汇票	客户L	客户L	100,000.00	2024-9-19	2025-3-19	客户L	客户	高可靠领域集成电路产品	是	100,000.00
商业承兑汇票	四川升华电源科技有限公司	四川升华电源科技有限公司	95,145.00	2024-9-25	2025-3-25	四川升华电源科技有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	95,145.00
商业承兑汇票	洛阳隆盛科技有限责任公司	洛阳隆盛科技有限责任公司	83,875.00	2024-11-26	2025-2-20	洛阳隆盛科技有限责任公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	83,875.00
商业承兑汇票	国科赛思(北京)科技有限公司	国科赛思(北京)科技有限公司	81,350.00	2024-7-17	2025-1-10	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	81,350.00
商业承兑汇票	客户H	客户H	77,841.50	2024-11-28	2025-5-27	客户H	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	中国电子科技集团公司第十研究所	中国电子科技集团公司第十研究所	74,750.00	2024-9-6	2025-3-3	湖南宏微电子技术有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	74,750.00
商业承兑汇票	兰州飞行控制有限责任公司	兰州飞行控制有限责任公司	73,250.00	2024-10-28	2025-4-28	客户S	客户	高可靠领域集成电路产品	是	73,250.00
商业承兑汇票	上海杰瑞兆新信息科技有限公司	上海杰瑞兆新信息科技有限公司	69,726.00	2024-7-24	2025-1-23	朝阳德林电子科技有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	69,726.00
商业承兑汇票	客户I	客户I	41,409.70	2024-11-28	2025-5-27	客户I	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户Q	客户Q	40,000.00	2024-11-26	2025-5-26	客户Q	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户Q	客户Q	40,000.00	2024-12-23	2025-6-23	客户Q	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	陕西锋火电子股份有限公司	陕西锋火电子股份有限公司	36,065.00	2024-9-4	2025-3-4	陕西泽瑞微电子股份有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	36,065.00
商业承兑汇票	客户J	客户J	31,000.00	2024-11-7	2025-5-7	客户J	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户I	客户I	30,186.09	2024-12-26	2025-6-25	客户I	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户Q	客户Q	30,000.00	2024-7-17	2025-1-17	客户Q	客户	高可靠领域集成电路产品	是	30,000.00
商业承兑汇票	客户Q	客户Q	30,000.00	2024-10-25	2025-4-25	客户Q	客户	高可靠领域集成电路产品	是	30,000.00
商业承兑汇票	天津七所精密机电技术有限公司	天津七所精密机电技术有限公司	27,450.00	2024-7-29	2025-1-22	客户R	客户	高可靠领域集成电路产品	是	27,450.00
商业承兑汇票	客户I	客户I	26,280.18	2024-10-29	2025-4-29	客户I	客户	高可靠领域集成电路产品	是	26,280.18
商业承兑汇票	客户J	客户J	25,200.00	2024-12-11	2025-6-10	客户J	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	客户J	客户J	19,250.00	2024-7-30	2025-1-29	客户J	客户	高可靠领域集成电路产品	是	19,250.00
商业承兑汇票	客户J	客户J	14,000.00	2024-12-20	2025-6-20	客户J	客户	高可靠领域集成电路产品	否	
商业承兑汇票	北京青云航空仪表有限公司	北京青云航空仪表有限公司	12,075.00	2024-10-30	2025-4-24	西安伟京电子制造有限公司	客户	高可靠领域集成电路产品	是	12,075.00
商业承兑汇票	天津七所精密机电技术有限公司	天津七所精密机电技术有限公司	11,425.00	2024-7-29	2025-1-22	客户R	客户	高可靠领域集成电路产品	是	11,425.00
商业承兑汇票	天津七所精密机电技术有限公司	天津七所精密机电技术有限公司	10,000.00	2024-7-29	2025-1-22	客户R	客户	高可靠领域集成电路产品	是	10,000.00
商业承兑汇票	中国船舶集团汾西重工有限责任公司	中国船舶集团汾西重工有限责任公司	7,250.00	2024-7-10	2025-1-10	客户S	客户	高可靠领域集成电路产品	是	7,250.00
商业承兑汇票	成都傅立叶电子科技有限公司	成都傅立叶电子科技有限公司	7,200.00	2024-10-18	2025-4-18	客户S	客户	高可靠领域集成电路产品	是	7,200.00
商业承兑汇票	客户N2	客户N2	2,580.00	2024-7-5	2025-1-4	客户N2	客户	高可靠领域集成电路产品	是	2,580.00
合计			28,155,899.86							11,388,131.88

公司持有的商业承兑汇票无对外背书转让或贴现的情形，截至2025年4月30日已到期的商业承兑汇票均已完成托收，无异常情形。

二、结合历史违约情况，说明商业承兑汇票环账计提比例上升的原因

公司商业承兑汇票主要来自高可靠领域客户，该部分客户或其票据出票人/承兑人通常信用较好，截至目前未出现商业承兑汇票到期后无法完成托收的情形。

公司在考虑商业承兑汇票的信用减值时，除考量承兑人、出票人的信用因素外，同时还将商业承兑汇票还原应收账款并根据还原后应收账款账龄情况计提信用减值损失。

2024年末，公司持有商业承兑汇票余额2,815.59万元，将其还原至应收账款后的账龄分别为1年以内741.41万元、1-2年2,074.18万元，还原后账龄为1-2年应收账款金额较大的原因主要系下游高可靠领域客户A、客户B等客户回款周期较长所致。

根据前述还原后应收账款账龄，按照应收账款信用减值损失计提模型计算合计应计提减值损失451.91万元，计提比例16.05%，较2023年末有所增加。

三、说明应收账款期后回款情况，并结合主要应收客户与账龄1-2年应收账款客户的还款能力和信用风险，说明相关款项的收回是否存在风险、环账准备的计提是否充分。

（一）应收账款期后回款情况

2024年末，公司应收账款余额8,497.43万元，截至2025年4月30日的期后收款为3,391.56万元，回款比例39.91%。

（二）主要应收账款客户情况

单位：万元

客户名称	期末余额	其中：1年以内	1-2年	客户性质	期后回款
客户A	807.39	807.39	-	高可靠领域	-
陕西亚成微电子股份有限公司	684.31	664.69	19.62	高可靠领域	98.76
瑞森半导体科技（广东）有限公司	647.78	581.03	66.75	其他领域	66.75
芜湖华元微电子有限公司	565.79	504.63	61.16	其他领域	167.31
客户E	533.64	491.74	41.90	高可靠领域	-
客户G	525.77	194.45	331.31	高可靠领域	518.17
盛廷微电子江苏有限公司	353.00	215.24	137.76	其他领域	200.00
宁波群芯微电子股份有限公司	328.40	226.62	101.78	其他领域	20.80
湖南宏微电子技术有限公司	314.06	314.06	-	高可靠领域	90.00
客户B	418.85	418.85	-	高可靠领域	235.00
深圳肇新电子科技有限公司	286.81	286.81	-	其他领域	210.09
客户K	264.03	215.80	48.23	高可靠领域	85.00
晶芝半导体有限公司	244.68	244.68	-	其他领域	244.68
无锡固电半导体股份有限公司	234.07	234.07	-	其他领域	127.85
合肥华耀电子工业有限公司	129.72	129.72	-	高可靠领域	46.43
瑞森半导体科技（湖南）有限公司	121.83	52.60	69.23	其他领域	-
西安伟京电子制造有限公司	112.08	70.32	41.76	高可靠领域	70.00
合计	6,572.22	5,652.72	919.49		2,180.84
应收账款余额	8,497.43	7,413.40	1,084.03		3,391.56
占比	77.34%	76.25%	84.82%		64.30%

注：其他领域包括消费电子领域、工业控制领域等。

1、高可靠领域客户

客户名称	期末应收账款余额（万元）	期后回款（万元）	情况描述
客户A	807.39	-	豁免披露
陕西亚成微电子股份有限公司	684.31	98.76	新三板挂牌公司（430552.NQ），目前已开展上市辅导
客户E	533.64	-	豁免披露
客户G	525.77	518.17	豁免披露
湖南宏微电子技术有限公司	314.06	90.00	宏达电子（300726.SZ）下属企业
客户B	418.85	235.00	豁免披露
客户K	264.03	85.00	豁免披露
合肥华耀电子工业有限公司	129.72	46.43	四创电子（600990.SH）下属企业
西安伟京电子制造有限公司	112.08	70.00	成立于2004年，民营企业，注册资本3,600万元
合计	3,789.85	1,143.36	

上述主要客户中高可靠领域客户共计9户，期末应收账款余额3,789.85万元，应收账款余额较大且1年以上达482.81万元。该部分客户主要系研究所或上市公司下属公司，均具有较强还款能力，信用风险较低。截至2025年4月30日，上述主要客户期后已回款1,143.36万元。客户A、客户E因其回款周期因素尚未有回款。其中1年以上应收账款仅客户E尚余41.90万元未回款，主要受其回款周期的影响，相关款项不存在收回风险。

2、其他领域客户

客户名称	期末应收账款余额（万元）	期后回款（万元）	客户性质	客户情况说明
瑞森半导体科技（广东）有限公司	647.78	66.75	终端客户	成立于2013年，注册资本3,000万元
芜湖华元微电子有限公司	565.79	167.31	终端客户	成立于2020年，注册资本2,535万元
盛廷微电子江苏有限公司	353.00	200.00	终端客户	成立于2019年，注册资本3,320万元
宁波群芯微电子股份有限公司	328.40	20.80	终端客户	成立于2018年，注册资本11,000万元
深圳肇新电子科技有限公司	286.81	210.09	经销商	成立于2021年，注册资本500万元
晶芝半导体有限公司	244.68	244.68	终端客户	成立于2019年，注册资本5,313.41万元
无锡固电半导体股份有限公司	234.07	127.85	终端客户	成立于2005年，注册资本500万元
瑞森半导体科技（湖南）有限公司	121.83	-	终端客户	成立与2022年，注册资本900万元，瑞森半导体科技（广东）有限公司的关联主体
合计	2,782.36	1,037.48		

上述客户中以民营企业为主，相关客户成立时间较长，已稳定运营多年，同公司的合作也很稳定，这些客户各自均具有一定的竞争优势产品及客户群体，具有一定的还款能力且信誉较好，应收账款可收回风险较低。截至2025年4月30日，上述主要客户期后已回款1,037.48万元。瑞森半导体科技（广东）有限公司及瑞森半导体科技（湖南）有限公司合计回款金额较低，对方已给出回款计划，从过往合作历史评估，回款风险可控。其中1年以上应收账款仅瑞森半导体科技（湖南）有限公司尚余69.23万元未回款。此外，公司已收到宁波群芯微电子股份有限公司转让的迪链债权凭证81.89万元，该债权凭证到期后将纳入回款中。

3、公司应收账款计提情况

公司2024年末应收账款账龄情况主要为1年以内，其中1年以内占比87.24%，扣除公司已收到中国电子惠融账单的715.70万元后，1年以内应收账款占比达到90.95%，应收账款账龄结构合理，1年以上应收账款占比较小，具体情况如下：

账龄	应收账款余额		扣除中国电子惠融账单后应收账款余额	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
1年以内	7,413.40	87.24%	7,077.24	90.95%
1-2年	1,084.03	12.76%	704.49	9.05%
合计	8,497.43	100.00%	7,781.72	100.00%

从公司应收账款信用损失模型角度来看，公司根据账龄和预期信用损失率计提信用减值损失，公司预期信用损失率与同行业可比公司相比不存在重大差异，具体情况如下：

公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
士兰微	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
华微电子	1.38%	21.51%	54.26%	85.41%	100.00%	100.00%
新洁能	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
东微半导	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
平均值	4.10%	15.38%	41.07%	96.35%	100.00%	100.00%
本公司	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

综上，根据公司主要客户的基本情况、还款能力、信用情况，以及公司账龄结构、预期信用损失计提比例角度来看，公司2024年末计提应收账款坏账准备587.48万元，计提比例6.91%，应收账款坏账计提具有充分性。

四、补充说明中国电子惠融账单相关信息、产生的原因以及相关款项回收是否存在困难。

中电惠融商业保理（深圳）有限公司（简称“中电惠融”）是中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）全资控股的商业保理公司，于2018年9月在深圳前海注册成立，注册资本金10亿元。

截至2024年末，公司收到并持有客户转让的中国电子惠融账单合计715.70万元，主要系客户G、客户K转让至公司所致。公司持有的中国电子惠融账单在期后均正常完成了托收，截至2025年4月30日已到期并完成托收的中国电子惠融账单金额603.17万元，未出现无法托收的情形，不存在收回困难的情形。

五、年审会计师意见

针对上述问题，经我们对公司2024年财务报表审计所执行的审计程序来看，我们认为：

（1）公司补充说明的商业承兑汇票相关信息与我们核查了解情况是相符的；

（2）公司商业承兑汇票计提比例上升主要系公司还原了应收账款账龄情况计提信用减值损失，而下游高可靠领域客户回款周期较长，导致2024年末公司持有的商业承兑汇票还原后账龄部分为1-2年，因此计提环账准备比例增加，具有合理性；

（3）截至2025年4月30日的期后收款为3,391.56万元，回款比例39.91%，回款情况良好。主要应收账款客户、账龄1-2年的应收账款，经公司评估不存在收回风险，公司环账准备计提充分；

（4）截至2024年末，公司收到并持有客户转让的中国电子惠融账单合计715.70万元，主要系客户G、客户K转让至公司所致，截至2025年4月30日已到期并完成托收的中国电子惠融账单金额为603.17万元，未出现无法托收的情形，不存在收回困难的情形。

六、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

1、公司已补充说明商业承兑汇票相关信息；

2、公司商业承兑汇票计提比例上升主要系公司还原了应收账款账龄情况计提信用减值损失，而下游高可靠领域客户回款周期较长，导致2024年末公司持有的商业承兑汇票还原后账龄部分为1-2年，因此计提环账准备比例增加，具有合理性；

3、